

## PRESS RELEASE

新加坡，2024 年 11 月 06 日

### **NexGen Wafer Systems | 耐晶科技推出 SERENO：集成計量的多功能高產能濕法蝕刻與清洗解決方案，支持 6 英寸、8 英寸及 12 英寸晶圓**

近日，耐晶科技隆重推出最新的多腔室設備 **SERENO** - 專為濕法蝕刻與清洗應用而設計。

**SERENO** 具有卓越的性能與高度的靈活性——配備了集成計量系統，用於精確控制晶圓厚度和粗糙度；內部化學供應系統支持多種工藝化學品，並具備集成混合、配比和化學分析能力，確保在晶圓擁有廣泛應用性與最佳適應性。

**SERENO** 佔地僅 12 平方米，每小時可高效處理 200 片晶圓。該平台專為前端（FEOL）和後端（BEOL）應用設計，旨在滿足半導體行業對更高性能、更高精度及更高成本效益的需求，是未來半導體製造的理想選擇。

### **高性能與緊湊設計的完美結合**

**SERENO** 在晶圓處理和工藝控制方面具備高度靈活性，支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸等多種晶圓尺寸。其多功能處理系統能夠高效處理從低於 100 微米的超薄晶圓到厚度超過 2 毫米的鍵合晶圓。高性能的工藝腔室結合創新的化學品分配和掃描控制，提供了最大的工藝自由度，確保晶圓處理的卓越表現。

耐晶科技首席行銷官 Christian Kleindienst 表示：“**SERENO** 在緊湊的空間實現了高性能的晶圓濕法蝕刻與清洗，同時也充分發揮了單片晶圓技術的靈活性，不僅滿足了客戶對高效單片晶圓解決方案的需求，還有效降低了企業運營成本，是替代傳統批量設備的理想之選。”

## SERENO 主要特性

- **高產能：**每小時處理高達 200 片晶圓。
- **占地面積：**僅 12 平方米。
- **先進的工藝控制：**客製化晶圓掃描與精確液體分配。
- **集成計量：**內置厚度與粗糙度計量，提供即時回饋，確保工藝一致性與品質。
- **高性能腔室：**業界領先的液體流量與排氣性能，確保無交叉污染。
- **多功能化學品供應：**內部儲存可支持多達三種工藝化學品，配有雙 90 升儲罐，確保工藝連續性。
- **靈活的晶圓處理：**支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸晶圓，包括超薄和易脆晶圓，並具備多晶圓尺寸的橋接工具功能。

## SERENO 應用領域

- **表面清洗**
  - 顆粒去除
  - 聚合物去除
  - 殘留物去除
  - 背面/倒角清洗
  - 晶圓清洗
- **薄膜與金屬蝕刻**
  - 背面/倒角薄膜蝕刻 (Silicon Nitride 氮化矽 | Silicon Dioxide 二氧化矽 | Polysilicon 多晶矽)
  - 金屬蝕刻 (Ti 鈦 | Ni 鎳 | Ag 銀 | Au 金 | Al 鋁 | W 鎢 | Cu 銅等)
  - 底部金屬層蝕刻 (Ag 銀 | Ni 鎳 | Ti 鈦等)
- **晶圓背面蝕刻**
  - 減薄
  - 應力消除
  - 表面調理
  - Via 顯露
- **支持的稱底**

- 矽 (Si) | 碳化矽 (SiC) | 氮化鎵 (GaN) | 砷化鎵 (GaAs) | 氧化鋁 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) | 氧化鋅 (ZnO)

## 供貨資訊

SERENO 現已接受訂單，首批交付將於 2025 年第一季度開始。如需了解更多資訊或安排演示，請聯繫耐晶科技：[sereno@nexgenws.com](mailto:sereno@nexgenws.com)。

## 關於 NexGen Wafer Systems | 耐晶科技

耐晶科技總部位於新加坡，是全球領先的半導體濕法蝕刻與清洗解決方案供應商。公司在奧地利設有工程與製造設施中心，擁有一支由 100 多名專業人員組成的國際化團隊，服務全球不同主半導體製造領域客戶。

透過位於新加坡的研究與展示實驗室，耐晶科技還為客戶打造一個靈活高效的合作平台，以加快濕法蝕刻與清洗工藝的開發，從而適應行業快速變化的研發節奏。

耐晶科技已在全球範圍內安裝超過 200 個處理腔體，正穩步向成為專用表面處理應用領域的國際領導者邁進。

更多資訊請訪問：<https://www.nexgen-wafer-systems.com/zh-hans/塞雷诺/>

更多耐晶科技的新聞資訊，請點[鏈接](#)

此新聞稿已上傳至[鏈接](#)

在 [LinkedIn](#) 追蹤耐晶動態

### 公司联系方式

Sabine Kosz

[publicrelations@nexgenws.com](mailto:publicrelations@nexgenws.com)

+43 676 840 346 400